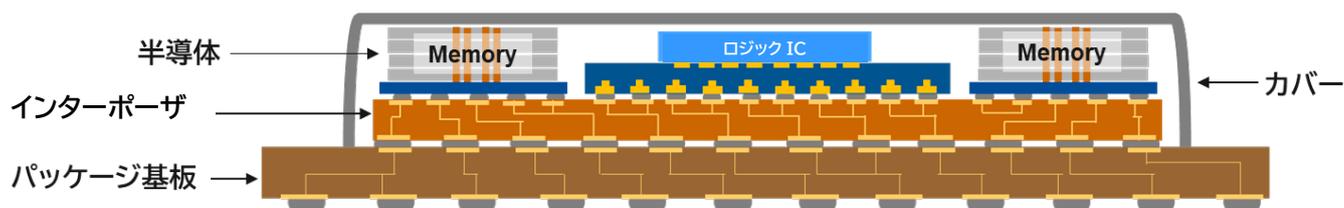


1 μ m 配線対応の Direct Imaging(DI)露光装置を出荷 ～世界初、密着配線 1 μ m、配線ピッチ 2.5 μ m を実現～

株式会社ブイ・テクノロジー(本社:神奈川県横浜市、代表取締役兼社長執行役員 杉本 重人)の子会社である株式会社 LE-TECHNOLOGY(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 李 梶)は、AI 半導体等で使用される最先端のインターポーザ開発に貢献する DI 露光装置(LAMBDI:読み「ラムデイ」)2号機を7月に出荷いたしましたので、ご案内いたします。

AI用半導体のチップセット

最先端の AI の学習や推論に用いられる半導体は、1 千億を超すトランジスタを搭載しており、ロジック IC やメモリ等の半導体を複数、多い時は 10 個以上搭載、インターポーザやパッケージ基板を介して、一つのチップセットとして機能します。



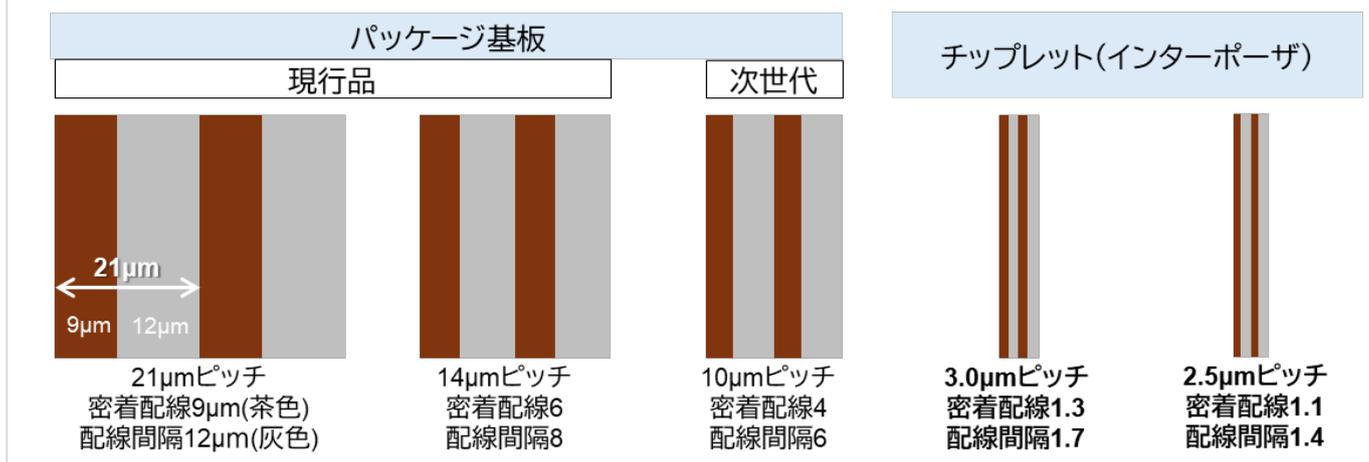
AI サーバー用半導体チップセットのイメージ

最先端のインターポーザからパッケージ基板の開発まで、広範に適用可能

最先端の基板製造においては、配線幅と配線間隔は均等ではなく、ピッチが重要視されます。

本装置は、高密度 FC-BGA からアドバンストパッケージ、そしてインターポーザの開発に適した高コントラストの投影光学系を搭載、非常に高い解像性を実現しており、次世代のパッケージ基板や、チップレットで想定される「密着配線幅 1 μ m、配線ピッチ 2.5 μ m」のインターポーザ製造に世界で初めて対応した DI 露光装置です。

パッケージ基板およびインターポーザの密着配線と配線間隔



今後について

Direct Imaging を用いる露光装置の市場は、より多層で高精細な回路からなる高付加価値なパッケージ基板への需要拡大や、ガラスをキャリア材として用い製造されるインターポーザや、ガラスをコア基材として用いるガラスコア基板によるインターポーザの量産が本格化していく中で、大きく成長するものと考えられています。

当社グループは、半導体やディスプレイ等の電子デバイスの多様な進化を支える革新的な技術の開発に注力していくとともに、大きいなる志と溢れる情熱で世界最高のイノベーションを創造し、社会に貢献してまいります。

以上

株式会社 LE-TECHNOLOGY

時代を先取り、従来とは一線を画するダイレクト露光装置を提供し、高い水準のイノベーションを実現する事で、お客様価値の最大化に貢献いたします。

- 本社:東京都千代田区四番町 4-19 CIRCLES 市ヶ谷 2F
- 代表取締役社長:李 梶
- Web サイト:<https://le-technology.co.jp/>
- 製品等のお問合せ先:03-4446-7529

株式会社ブイ・テクノロジー

- 本社:神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134横浜ビジネスパークイーストタワー9F
- 事業内容:半導体・フォトマスク装置事業、他
- Web サイト:<https://www.vtec.co.jp/ja/index.html>

<本リリースのお問い合わせ先>

- 株式会社ブイ・テクノロジー IR 室 吉村
- TEL:045-338-1981
- E-MAIL: vtj-ir@vtec.co.jp